

# 光大证券股份有限公司关于无锡力芯微电子股份有限公司 调整募投项目内部投资结构及募投项目延期核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和《科创板上市公司持续监管办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构”）作为无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“力芯微”、“发行人”、“公司”）的保荐机构，对公司调整募投项目内部投资结构及募投项目延期情况进行了核查，具体情况如下：

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡力芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1593号）同意，公司首次公开发行人民币普通股1,600.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币36.48元，本次发行募集资金总额为人民币583,680,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币71,236,470.12元，募集资金净额为人民币512,443,529.88元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具容诚验字[2021]230Z0102号《验资报告》。

根据公司《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金采取专户存储管理。2021年6月23日，公司与保荐机构、募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司无锡新区支行、宁波银行股份有限公司无锡新区支行、招商银行股份有限公司无锡新区支行和中信银行股份有限公司无锡新区支行签订了《资金专户存储三方监管协议》。

## 二、募集资金投资项目情况

根据《无锡力芯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目计划，以及公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议根据公司实际募集资金净额调整后的各

募投项目拟投入募集资金情况及相关信息详见公司于2021年8月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额以及使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

截至2022年12月31日，公司募投项目进展情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额	累计投入募集资金金额	投入进度（%）
1	高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目	17,889.96	17,889.96	15,448.05	8,222.14	53.22
2	高性能电源防护芯片研发及产业化项目	17,036.17	17,036.17	14,734.66	4,047.89	27.47
3	研发中心建设项目	8,403.56	8,403.56	6,021.64	1,285.93	21.36
4	发展储备项目	18,000.00	18,000.00	15,040.00	3,209.05	21.34
	合计	61,329.69	61,329.69	51,244.35	16,765.01	/

### 三、募投项目内部投资结构调整的具体情况

#### （一）调整募投项目内部投资结构的原因

为进一步提高募集资金使用效率、加快募投项目的实施进度，更加科学安排和调动资源，公司根据最新市场环境、募投项目实施情况以及未来资金投入规划，公司需要扩大研发队伍，扩充项目产品线，加快推进新产品进入量产，同时受下游需求波动的影响，掩膜费用和试生产费相对募投项目规划时有所下降。在募集资金投资项目实施主体、募投项目总投资金额、募集资金投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施进展的情况下，对“高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目”“高性能电源防护芯片研发及产业化项目”“研发中心建设项目”的内部投资结构进行调整，主要调增了“人工费用”“铺底流动资金”，相应调减“固定资产”“无形资产”。

#### （二）调整募投项目内部投资结构的具体情况

单位：万元

项目名称	投资明细项目	原计划募集资金投入金额	现拟募集资金投入金额	增减情况
高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目	<b>1.新增固定资产</b>	<b>2,682.49</b>	<b>482.49</b>	<b>-2,200.00</b>
	1.1.硬件设备购置费用	2,591.82	391.82	-2,200.00
	1.2.装修费用	90.67	90.67	-
	<b>2.新增无形资产</b>	<b>779.74</b>	<b>179.74</b>	<b>-600.00</b>
	2.1.软件购置费用及安装费用	779.74	179.74	-600.00
	<b>3.新增开发投资</b>	<b>10,089.19</b>	<b>11,489.19</b>	<b>1,400.00</b>
	3.1.人工费用	4,390.05	7,590.05	3,200.00
	3.2.研发掩膜费用	3,108.62	2,308.62	-800.00
	3.3.试生产费	2,590.52	1,590.52	-1,000.00
	<b>4.预备费</b>	<b>207.73</b>	<b>207.73</b>	<b>-</b>
	<b>5.铺底流动资金</b>	<b>1,688.90</b>	<b>3,088.90</b>	<b>1,400.00</b>
合计	<b>15,448.05</b>	<b>15,448.05</b>	<b>-</b>	
高性能电源防护芯片研发及产业化项目	<b>1.新增固定资产</b>	<b>2,662.84</b>	<b>562.84</b>	<b>-2,100.00</b>
	1.1.硬件设备购置费用	2,597.97	437.97	-2,160.00
	1.2.装修费用	64.87	124.87	60.00
	<b>2.新增无形资产</b>	<b>867.50</b>	<b>67.50</b>	<b>-800.00</b>
	2.1.软件购置费用及安装费用	867.50	67.50	-800.00
	<b>3.新增开发投资</b>	<b>9,398.05</b>	<b>10,598.05</b>	<b>1,200.00</b>
	3.1.人工费用	3,689.68	7,189.68	3,500.00
	3.2.研发掩膜费用	3,113.66	1,713.66	-1,400.00
	3.3.试生产费	2,594.71	1,694.71	-900.00
	<b>4.预备费</b>	<b>211.82</b>	<b>211.82</b>	<b>-</b>
	<b>5.铺底流动资金</b>	<b>1,594.45</b>	<b>3,294.45</b>	<b>1,700.00</b>
合计	<b>14,734.66</b>	<b>14,734.66</b>	<b>-</b>	
研发中心建设项目	<b>1.新增固定资产</b>	<b>3,379.85</b>	<b>2,579.85</b>	<b>-800.00</b>
	1.1.硬件设备购置费用	3,170.26	1,000.26	-2,170.00
	1.2.装修费用	209.59	1,579.59	1,370.00
	<b>2.新增无形资产</b>	<b>698.83</b>	<b>1,498.83</b>	<b>800.00</b>
	2.1.软件购置费用及安装费用	698.83	1,498.83	800.00
	<b>3.新增开发投资</b>	<b>1,698.24</b>	<b>1,698.24</b>	<b>-</b>
	3.1.人工费用	1,125.00	1,125.00	-
	3.2.材料费用	573.24	573.24	-
	<b>4.预备费</b>	<b>244.72</b>	<b>244.72</b>	<b>-</b>
合计	<b>6,021.64</b>	<b>6,021.64</b>	<b>-</b>	

#### 四、本次募投项目延期的具体情况

### （一）本次募投项目延期原因

自各募投项目实施开始，受宏观环境的不利影响，以及下游需求波动的影响，募投项目实际进度与计划进度存在着一定的差异，总体研发工作未达预期、实施进展滞后。为提高募集资金利用率、提升募投项目与公司的协同效率、满足公司长期发展及产业布局的要求，结合实际经营情况，公司在充分考虑当前项目建设进度及募集资金使用情况的基础上，通过综合评估分析，以及审慎的研究论证，拟将首次公开发行股份募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。

### （二）募投项目延期的具体情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整的情况如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目	2023年6月	2024年6月
2	高性能电源防护芯片研发及产业化项目	2023年6月	2024年6月
3	研发中心建设项目	2023年6月	2024年6月
4	发展储备项目	2023年6月	2024年6月

### （三）本次部分募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定：超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，科创公司应当重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证，决定是否继续实施该项目。

#### 1、高性能电源防护芯片研发及产业化项目

公司对“高性能电源防护芯片研发及产业化项目”的必要性及可行性进行重新论证。上述项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，项目继续实施仍具备必要性和可行性。

## （1）项目建设的必要性

安全、稳定的电源方案是电子产品正常工作的基础保障，是电子设备不可或缺的基本组件和生命线，而电源防护芯片的防护性能决定了电源使用寿命、核心部件的安全性。随着终端应用市场对电源防护类产品功能要求的不断提升，公司需不断提升产品性能指标，并增加产品功能、扩充产品种类，以全面的产品系列满足客户不同需求；同时，由于不同应用领域的电子产品对于电源防护产品的需求侧重点不同，公司需要持续研发电源防护领域的新技术、新产品，拓展防护类产品应用领域。

以电源防护产品中较为主要的 OVP 系列为例，公司 OVP 产品系列的功能已从单一的过压保护点设置方式扩展到适合不同方案的多电压可调节方式，并逐步集成路径开关和电源监测等功能，防护性能标准也从 80V 逐渐提升至业内少有的 200V，瞬变电压关断速度从微秒级提升到至纳秒级。上述产品功能及性能的进步，是公司通过技术和产品的研发创新，来推动应用的过程。因此，电源防护芯片需要通过持续研发，才能实现产品的优化、创新及产业化。

因此，高性能电源防护芯片研发及产业化项目，有利于公司保持并加强在电源防护类芯片领域的竞争优势，从而提高公司盈利能力，保持企业竞争力。

## （2）项目建设的可行性

### ①长期稳定的客户资源为项目实施奠定良好的市场基础

公司产品的销售领域主要涉及手机类、家电类、LED 大屏显示、等多个领域，各领域对产品的性能要求、服务需求、供货周期、竞争力度等，各不相同，为此公司制定了适合于不同行业领域的销售细分策略。公司一方面与资深电子元器件经销商结成了长期的合作伙伴关系，并通过经销商的丰富终端客户资源，实现大规模销售；另一方面，公司已经发展包括三星、LG 及小米等国内外知名客户。与其建立了长期稳定的合作关系。优质且广泛的客户资源是公司保持快速成长和持续经营的根基和保障。公司凭借着严格的质量控制，较高的研发水平，依靠成熟的经销渠道、良好的产品品质和及时的技术支持，使公司在行业内建立良

好的信誉及品牌知名度，培育了庞大的客户群，公司在客户资源数量和质量上具备明显优势，众多长期稳定的客户资源，为本次项目的实施奠定了良好的市场基础。

## ②优质的人才及技术储备为项目实施奠定坚实基础

集成电路行业是技术高度密集型行业，而 IC 设计厂商作为集成电路产业链的上游，对厂商的技术研发要求也相当严苛，IC 设计厂商的竞争优势也建立于公司所积累的技术储备及技术人才，且模拟电路设计业相对于数字电路设计业来说更加依赖技术人员的工艺及经验。而公司自 2002 年成立以来，一直保持着稳定高素质的人才团队，截止至 2022 年末，公司员工总人数 380 人，其中研发团队 199 人，占员工总人数的 52.37%，大多具有本科以上学历，且其中包含较多具备丰富行业经验的技术人才。

近年来，公司共获得各项集成电路布图设计 52 项，发明专利 47 项，以及 26 项实用新型专利。在技术创新能力不断实现自我突破的过程中，公司注重对专业人才的培养，目前已拥有一支高素质的技术队伍，拥有国内一流的模拟集成电路设计专家，并且在研发技术和产品的多年实践中，积累了相当丰富的经验。公司所积累的优质技术储备及优秀的技术团队为本次项目的实施奠定坚实的技术基础。

## 2、研发中心建设项目

公司对“研发中心建设项目”的必要性及可行性进行重新论证。上述项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，项目继续实施仍具备必要性和可行性。

### (1) 项目建设的必要性

设计创新和研发实力是集成电路设计企业竞争力的核心体现，而研发实力提升离不开技术人才储备和基础研发架构的搭建，人才、设备、辅助工具均为企业发展必不可少的支撑。

公司虽已成为国内消费电子领域主要的电源管理芯片设计企业之一，并在电源转换、电源防护、显示驱动等产品领域积累了丰富的研发经验、技术和大量优秀的专业人才，但激烈的市场竞争和高性能产品的进口替代需求驱动着公司持续投入研发，并通过不断吸引业内优秀人才、加强人才培养来保持竞争力。

## **(2) 项目建设的可行性**

### **1) 技术团队为项目的实施提供了人才支撑**

人才是集成电路设计企业的基石。公司始终注重技术人才团队建设，并不断通过人才引进、自主培养等方式储备，使得研发团队不断发展壮大。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已拥有 199 名研发及技术人员，占比 52.37%，并形成了多个技术团队，为研发中心建设项目的实施提供了人才支撑。

### **2) 多年积累形成的技术体系为项目的实施奠定了技术基础**

技术创新是 IC 设计公司发展的驱动力。公司围绕电源管理芯片低噪声、高性能、微型化及集成化等发展趋势形成了丰富的核心技术和功能模块 IP，并以此为基础形成了覆盖电源转换、电源防护等多类别设计平台。上述研发体系不仅为上述技术体系在应用中得到市场验证并不断优化，为研发中心建设项目的顺利实施奠定了技术基础。

## **3、发展储备项目**

公司对“发展储备项目”的必要性及可行性进行重新论证。上述项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，项目继续实施仍具备必要性和可行性。

### **(1) 项目建设的必要性**

集成电路设计企业是典型的技术密集型行业。随着下游市场需求的快速变化，对集成电路产品创新提出了较高的要求。在此背景下，集成电路设计企业需要保持较强的持续创新能力，紧密追踪上下游技术变动，不断储备新技术、新产

品，才能满足多变的市场需求。因此，募集资金用于发展储备项目，能够进一步加强公司在新技术、新产品方面的储备，扩充产品种类，保持企业竞争力。

公司基于在手机等消费电子应用领域的市场地位，以市场需求和技术前沿趋势为导向，制定了未来发展战略规划。公司将持续开展技术创新与产品开发、进一步开拓市场、加强优秀人才培养和引进，继续研发全系列、高品质的电源管理芯片，并在信号链芯片等市场布局，从而为公司打造领先的电源管理芯片技术平台，并最终成为国际一流的模拟芯片供应商奠定基础。

发展储备项目具体投向正是基于公司未来战略规划需要，在高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目等募集资金投资项目之外，加强在信号链芯片、磁感应芯片、PMU 等领域的研发力度，是未来发展战略规划的重要环节。

## **(2) 项目建设的可行性**

公司发展储备项目是在公司现有重点产品的基础上，结合技术需求、战略规划和市场趋势，优先用于符合公司战略发展规划的、正在储备和开拓的，除高性能电源转换及驱动芯片研发及产业化项目、高性能电源防护芯片研发及产业化项目之外的其他方向的技术开发、储备和产业化。

考虑到公司在 PMU、磁感应芯片、信号链芯片等领域已实现了一定的技术积累，并在少量产品布局、市场推广等方面取得了一定进展。因此，募集资金用于发展储备项目，有利于公司结合现有技术、业务基础，根据市场及技术变化进行布局。

## **五、本次募投项目内部结构调整及募投项目延期事项的影响**

本次募投项目内部结构调整是结合公司募投项目未来实施规划及实际业务发展运营的需要，与募集资金投资项目保持一致，旨在合理优化公司现有资源，提高募集资金使用效率，有利于推进募投项目的顺利实施，符合公司长期利益及募集资金使用安排。本次调整和延期未改变相关投资项目的总体要求、投资总额，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。



本次募投项目延期是公司根据目前募投项目的实际建设情况和投资进度做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。公司后续将进一步加快推进部分募投项目建设进度，促使部分募投项目尽快达到预定可使用状态。

## **六、履行的审议程序和相关意见**

公司于2023年6月26日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》，公司独立董事对本次议案进行了认真核查后发表了同意的意见；本议案无需提交股东大会审议。

### **（一）独立董事意见**

公司全体独立董事认为：公司本次募投项目内部结构调整及募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次募投项目延期的事项。

### **（二）监事会意见**

监事会认为：公司本次募投项目内部结构调整及募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。

因此，公司监事会同意本次募投项目内部结构调整及募投项目延期事项。

## 七、保荐机构的核查意见

保荐机构认为：本次公司调整募投项目内部投资结构及募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，无需提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序。本次调整募投项目内部投资结构及募投项目延期事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次募投项目内部结构调整及募投项目延期事项无异议。

(此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于无锡力芯微电子股份有限公司调整募投项目内部投资结构及募投项目延期核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： 王如意

王如意

林剑云

林剑云

